Lotpaste AP-10 Sn63Pb37 / Sn62Pb36Ag2

Produktbeschreibung

Lotpaste AP-10 ist eine aktivierte bleihaltige Lotpaste auf Basis von modifizierten, natürlichen Harzen, geeignet für den Reflowprozess an Luft und unter Stickstoff. Lotpaste AP-10 hat ein breites Prozessfenster und bietet eine gute Aktivität auf nahezu allen Metallisierungen. AP-10 ist für einfache Anwendungen in der Nachrichtentechnik, Mikroelektronik und an gedruckten Schaltungen geeignet. Die Paste ist robust und hat eine lange Offenzeit. Druckpausen bis zu 60 min sind möglich, wobei bei weniger feinen Strukturen ein Probedruck nicht erforderlich ist. Die Flussmittelrückstände sind hell-bernsteinfarben, nicht korrosiv und müssen in den meisten Fällen nicht entfernt werden. Ist ein Waschen erforderlich, sind die Rückstände gut abwaschbar mit Alkoholen und Gemischen aus halogenierten Kohlenwasserstoffen und Alkoholen.

- Gute Benetzung auf den üblichen metallischen Oberflächen
- Gute Dosierbarkeit
- Hohe Aktivität auf allen Substraten
- Lange Offenzeit
- Gute Klebrigkeit bis zu 8 h
- Flussmittelklassifizierung: J-STD-004: ROL1
- Geeignet für alle Lötverfahren mit indirekter Erwärmung
- Gute Waschbarkeit der Flussmittelrückstände

Testergebnisse

Klebrigkeit > 8 h
Konturenstabilität: bestanden
IPC-TM-650, Methode 2.4.35
Lotkugel-Test: bestanden
IPC-TM 650, Methode 2.4.43
Kupferspiegeltest: L
IPC-TM-650, Methode 2.3.3
Silber-Chromat-Papiertest: bestanden
IPC-TM-650,Methode 2.3.35.1

Isolationswiderstand

J-STD-0004, IPC-TM-650, Methode 2.6.3.3:

AP-10, ungereinigt nach 24 h:	9.6×10^{8} Ω
AP-10, ungereinigt nach 96 h:	1.0×10^{9} Ω
AP-10, ungereinigt nach 168 h:	1.0×10^{9} Ω
Kontrollbord nach 24 h:	1.1×10^{10} Ω
Kontrollbord nach 96 h:	1.2×10^{10} Ω
Kontrollbord nach 168 h:	1.2×10^{10} Ω

Für die Lotpaste AP-10 Sn63Pb37 T3 90 % liegt ein Prüfbericht der Siemens AG vor, der bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden kann

Physikalische Eigenschaften

Daten für SnPb(Ag)-Lote, 86 – 90 % Metall, Pulvertyp 3, 25 – 45 µm
Viskosität 350 – 500 Pa·s

Legierung	Sn [%]	Pb [%]	Ag [%]	Schmelzpunkt/-bereich [°C]
S-Sn63Pb37	63 ± 0,5	37 ± 0,5	-	183
S-Sn62Pb36Ag2	62 ± 0,5	36 ± 0,5	2 ± 0,2	179

Elblinger Elektronik GmbH
Lange Wanne 25
38259 Salzgitter

Telefon 05341/8212-1
Fax 05341/821299

e-mail mail@elblinger-elektronik.de
Internet www.elblinger-elektronik.de

Reinigung

AP-10 ist eine no clean Paste. Die Rückstände müssen nicht entfernt werden, können aber mit Lösungsmitteln wie Ethanol, Isopropanol oder Gemischen aus Alkohol und halogenierten Kohlenwasserstoffen, leicht gelöst werden, falls dies gefordert ist.

Verpackung

Stülpdeckeldosen mit Innenschieber: 250, 500 und 1000 g
Kartuschen: 600 und 1200 g
Spritzen: 30 ccm (100 g)

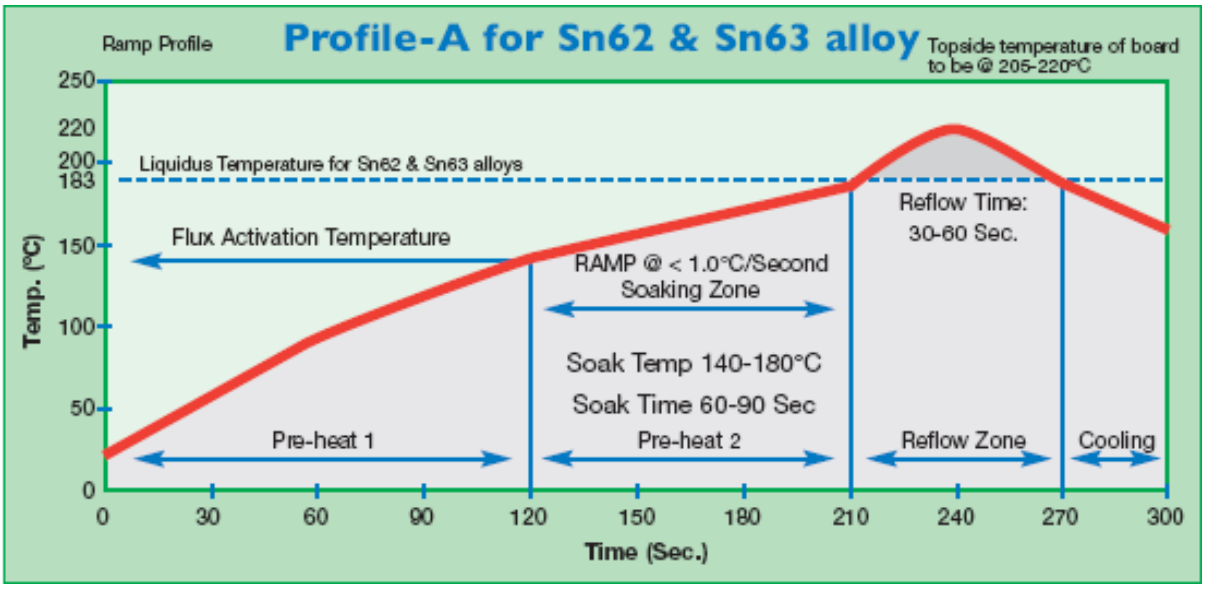
Lagerung

Dosen:	maximal 6 Monate im geschlossenen Behälter bei 6 - 16 °C
Kartuschen:	maximal 3 Monate senkrecht stehend bei 6 – 16 °C

Drucken

Rakel:	Edelstahlrakel
Rakelgeschwindigkeit:	25 – 50 mm/s
Schablone/Sieb:	Edelstahl
Umgebung:	Optimaler Temperaturbereich 21 – 25 °C, rel. Luftfeuchte 40 – 65 %

Reflowprofil



Vorstehende Angaben sollen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit oder Gewährleistung kann jedoch aufgrund der Vielseitigkeit der Materialien, der Anwendungen, auch bezüglich der Schutzrechte Dritter, nicht übernommen werden.

Elblinger Elektronik GmbH
Lange Wanne 25
38259 Salzgitter

Telefon 05341/8212-1
Fax 05341/821299

e-mail mail@elblinger-elektronik.de
Internet www.elblinger-elektronik.de